



## Soitec étend son partenariat avec UMC afin de fournir des substrats de haute technicité pour la toute première solution de circuits intégrés 3D pour RF-SOI

- *Soitec et UMC sont partenaires depuis plus de 11 ans dans la fourniture de solutions RF-SOI de premier plan.*
- *Le partenariat s'étend désormais aux futures solutions de circuits intégrés 3D pour la 5G et les futurs systèmes de communication sans fil fonctionnant dans les fréquences d'ondes millimétriques et au-delà.*

**Bernin (France), le 13 juin 2024** - Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour l'extension de son partenariat avec UMC, l'une des principales fonderies de semi-conducteurs au monde, afin de mettre sur le marché la première solution de circuit intégré 3D pour la technologie RF-SOI (*Radio Frequency Silicon-on-Insulator*) à l'ère de la 5G.

La solution 3D IC d'UMC pour la technologie RF-SOI relève le défi d'intégrer davantage de modules frontaux radiofréquences (RF) - composants essentiels des smartphones qui transmettent et reçoivent les données - dans un seul appareil en empilant verticalement les puces et en utilisant la technologie de collage plaque à plaque. Elle réduit la taille des puces de plus de 45 %, ce qui permet aux clients d'intégrer davantage de composants RF pour répondre aux exigences de la 5G en matière de bande passante.

Les substrats RF-SOI de Soitec jouent un rôle essentiel en fournissant les performances mécaniques et électriques nécessaires pour assurer la fabrication en grand volume de la solution d'UMC sans dégradation des performances en matière de radiofréquence.

S'appuyant sur une collaboration qui remonte à 2013, Soitec et UMC sont fiers de présenter leur dernier partenariat dans le domaine de la technologie RF-SOI, apportant des innovations déterminantes qui améliorent la performance et l'efficacité des applications 5G dans le monde entier.

*"Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec UMC, qui s'étend désormais au tout premier circuit intégré 3D pour RF-SOI de l'industrie. L'expérience et l'expertise conjuguées d'UMC et de Soitec nous placent dans une position idéale pour stimuler l'innovation et répondre aux défis futurs des modules frontaux RF à faible consommation d'énergie tout en optimisant leur volume. En étendant le domaine des solutions RF-SOI à l'intégration 3D, les futurs smartphones s'adapteront aux nouvelles bandes de fréquences envisagées pour l'ère 5G-Advance et 6G, tout en faisant de la place pour les nouvelles fonctionnalités à venir. Dans le même temps, les futurs appareils à réalité augmentée et autres appareils IoT bénéficieront de modules frontaux RF compacts, offrant de meilleurs taux de transmission de données tout en garantissant une grande efficacité énergétique",* déclare Jean-Marc Le Meil, Executive Vice President de la Division Communications Mobiles de Soitec.



*"Soitec a été un partenaire clé d'UMC pour faire progresser les communications mobiles au fil des ans grâce à ses substrats innovants à la pointe de la technologie. S'appuyant sur notre solide partenariat avec Soitec, la solution innovante de circuits intégrés 3D d'UMC pour RF-SOI a suscité un vif intérêt de la part des clients qui cherchent à intégrer davantage de composants RF dans les appareils mobiles compatibles avec la 5G sans faire de compromis sur le facteur de forme ou les performances. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Soitec pour cibler le marché de la 5G mmWave et au-delà ", a déclaré Raj Verma, Associate Vice President of Technology Development chez UMC.*

### **À propos de Soitec**

Soitec (Euronext – Tech 40 Paris), leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l'innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis son siège mondial, Soitec se déploie à l'international grâce à ses solutions uniques. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie et objets intelligents. L'entreprise s'appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 100 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : <https://www.soitec.com/fr>

### **Contacts**

Relations médias : [media@soitec.com](mailto:media@soitec.com)

Relations investisseurs : [investors@soitec.com](mailto:investors@soitec.com)